

JEITA チップレットソリューションWG

- チップレット技術における必要な要件を調査し、標準等の整備を行う
 - ・会員企業へ調査した最新情報を共有
 - ・チップレットのセキュリティーに関する国際標準化への対応

半導体標準化専門委員会

半導体システムソリューション技術委員会

チップレットソリューションWG(新設)

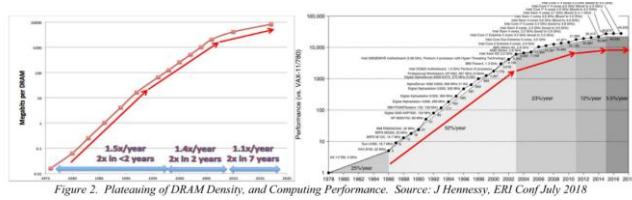
ヘテロジニアスインテグレーションTG(新設)

活動内容

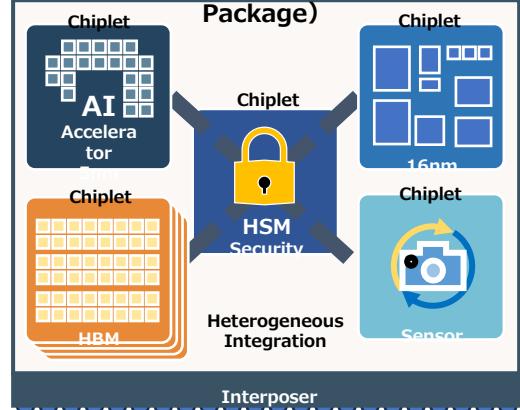
- ・標準化や業界活動の動向調査（HIR、Chiplet Summit）
- ・業界団体との情報交換会（ASRA、SEAJ）
- ・情報共有のための勉強会

ヘテロジニアスインテグレーションとは

✖ ムーアの法則が頭打ちに



チップレット技術を用いたSiP (System in Package)



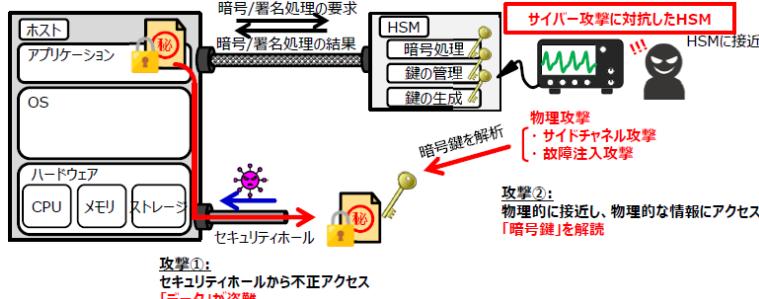
ハードウェアセキュリティ検討TG(新設)

活動内容

- ・チップレットにおけるセキュリティ実装方法の議論
- ・国際的な動向の調査
- ・IEC等における標準化への対応

ハードウェアセキュリティにおけるHSM (Hardware Security Module) とは

HSMは、「サイバー攻撃耐性」は高いが「物理攻撃耐性」が低い



「物理攻撃耐性」を高めるためのチップレット集積におけるHSM実装方法を検討

- ・Root of Trustの主体
- ・セキュリティ機能の選択・分担
- ・設計自由度の確保（非固定化）

※WGに参加するためにはサブコミッティに所属する必要があります（年会費：¥144,000/社）。
※サブコミッティ内のどのWGに、何人参加しても、同一料金です。

お問合せ先：一般社団法人電子情報技術産業協会 事業戦略本部事業推進部担当：岩渕・遠山
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 E-mail : device3@jeita.or.jp

